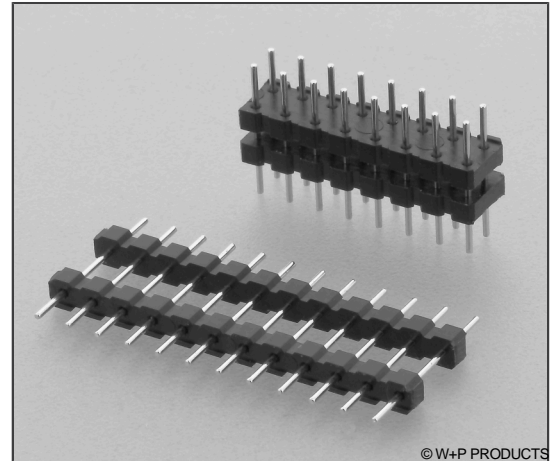


## Sandwich-Stiftleisten RM 2,54mm, 1-/2-reihig – Rundkontakte 0,5mm Dual Body Pin Headers, 2.54mm Pitch, Single/Double Row – 0.5mm Round Contacts

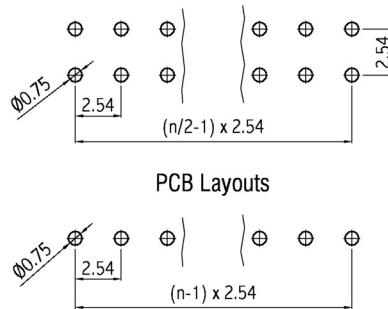
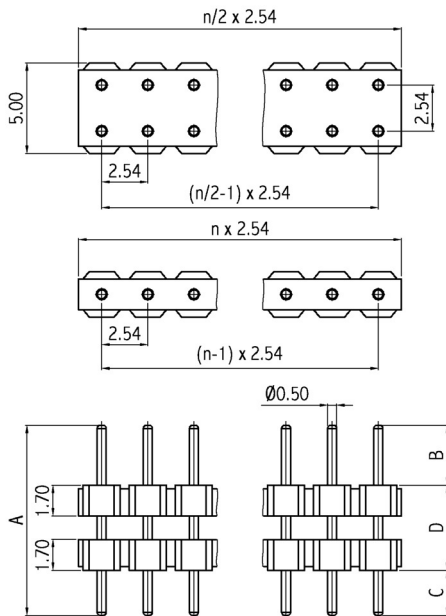
### Technische Daten / Technical Data

Isolierkörper <i>Insulator</i>	Thermoplast, nach UL94 V-0 <i>Thermoplastic, rated UL94 V-0</i>
Kontaktmaterial <i>Contact Material</i>	Rundstift Ø0,50mm, Kupferlegierung <i>Ø0.50mm round pin, copper alloy</i>
Kontaktoberfläche <i>Contact Surface</i>	Lt. Oberflächenoptionen, über Ni <i>Acc. to options (see below), over Ni</i>
Durchgangswiderstand <i>Contact Resistance</i>	< 20 mΩ
Isolationswiderstand <i>Insulation Resistance</i>	> 1000 MΩ
Spannungsfestigkeit <i>Test Voltage</i>	500 V AC
Nennspannung <i>Voltage Rating</i>	250 V AC
Nennstrom <i>Current Rating</i>	1 A
Temperaturbereich <i>Temperature Range</i>	-40 °C ... +125 °C
Verarbeitung <i>Processing</i>	Wellen- oder Reflow-Lötverfahren <i>Wave or reflow soldering</i>



© W+P PRODUCTS

Passende Buchsenleisten:  
*Compatible Female Headers:*  
**182 186 256** etc.  
Weitere siehe Kapitel D  
*Please see ch. D for more*



PCB Layouts

<b>Series</b>	<b>Dimensions*</b>	<b>Contacts*</b>	<b>Rows*</b>	<b>Plating*</b>
<b>953</b>	<b>12</b> 12 A=11,30 B=3,30 C=3,30 D=4,70mm 13 A=12,60 B=3,30 C=3,30 D=6,00mm 15 A=14,70 B=3,30 C=3,30 D=8,10mm A/B/C Gesamtlänge & Wunschmaße <i>Total length &amp; Dimensions</i>	<b>036</b> 002-040 Einreihig <i>Single row</i> 004-080 Zweireihig <i>Double row</i>	<b>2</b> 1 Einreihig <i>Single row</i> 2 Zweireihig <i>Double row</i>	<b>00</b> 00 Vergoldet <i>Gold plated</i> 50 Verzinkt <i>Tin plated</i>

Wir fertigen die Stiftleisten in jeder gewünschten Polzahl. Raster 5,08mm, 7,62mm, etc. oder Sonderraster auf Anfrage.

*We will manufacture the pin headers in every desired number of contacts. 5,08mm, 7,62mm, etc. and more pitches on request.*

Maximale Stiftlänge: 17mm  
*Maximum Pin Length: 17mm*

\* Dies ist ein **Bestellbeispiel** - bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.  
\* *This is an order example - please replace by your specifications.*

# Informationen zum Wellen-Lötverfahren

## Wave Soldering Information

### Empfehlungen für das Wellenlötverfahren

#### Recommendations for Wave Soldering

Die Bauteile sollten bei einer Lötbadtemperatur von 260°C in max. 5 Sekunden verlötet werden.

Empfohlenes Wellenlötprofil:



## Informationen zum Reflow-Lötverfahren Reflow Soldering Information

### Reflow-Lötempfehlung für kurze Lötzeiten

Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

Profileigenschaft	Kennwert
Temperatur Minimum $T_{Smin}$	150 °C
Temperatur Maximum $T_{Smax}$	200 °C
Dauer $T_{Smin} - T_{Smax}$	60 – 180s
Temperatur Lötbereich $T_L$	217 °C
Verweildauer oberhalb $T_L$	60 – 180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3 °C / s
Höchsttemperatur $T_P$	260±5 °C
Dauer Höchsttemperatur	20 – 40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6 °C / s
Dauer 25 °C – Höchsttemperatur $T_P$	max. 8m

### Reflow Soldering Recommendation For Shorter Peak Times

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).

Profile Feature	Key Values
Minimum Temperature $T_{Smin}$	150 °C
Maximum Temperatur $T_{Smax}$	200 °C
Duration $T_{Smin} - T_{Smax}$	60 – 180s
Soldering Range Temperature $T_L$	217 °C
Duration above $T_L$	60 – 180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3 °C / s
Peak Temperature $T_P$	260±5 °C
Duration Peak Temperature	20 – 40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6 °C / s
Duration 25°C - Peak Temp. $T_P$	max. 8min

